

카메라 모듈용 연경성 인쇄회로기판 (Rigid Flex PCB for Camera Module)

대덕전자(주) - Daeduck Electronics Co.,Ltd

■ 기업 소개

대덕전자는 반도체 및 Mobile 통신기기 등 각 분야에 걸쳐서 첨단 PCB를 공급하고 있습니다. 현재 CSP, MCP, SiP, Flip-chip, BOC 등의 반도체용 PCB 및 HDI, SLP 등의 스마트폰 메인기판, Cavity Flexible, Rigid-Flexible 등의 카메라모듈, 웨어러블 기기, Build Up, MLB 등의 자동차용 전장과 네트워크 등에 사용되는 PCB를 주력으로 생산하고 있으며, 세계 유수의 국내외 반도체 제조사 및 IT업체에 공급되고 있습니다.

또한 4차 산업을 주도할 5G통신, 인공지능, 빅데이터 등의 기술에 요구되는 대용량, 다기능화, 초박판화에 대응하기 위해 선형기술을 확보하여 첨단 제품을 생산하고 있으며, Flexible에서 PKG기판에 이르는 전 종류의 기판을 생산하는 PCB전문 기업회사로서 다양한 제품 포트폴리오와 차별화된 기술로 글로벌 시장을 적극적으로 개척하고 있습니다.

■ 기업 사업장 현황

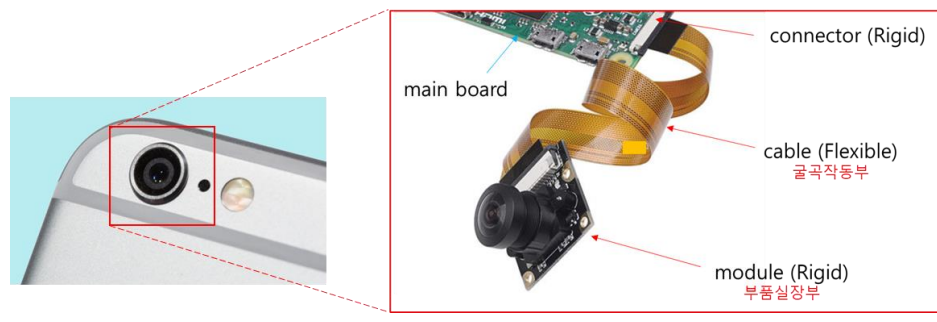
PKG	Mobile	MLB
		
경기도 시흥 / 안산	경기도 안산(목내동)	경기도 안산(원시동)
		
	베트남 빈푹 산업단지	필리핀 카비테

■ 제품개요 및 제품 사진

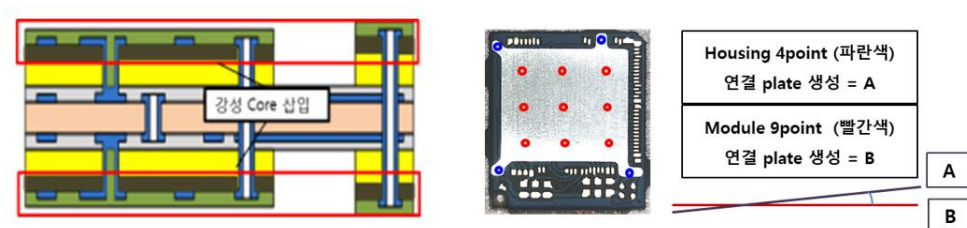
카메라 모듈용 Rigid Flex PCB
 카메라 모듈용 Rigid Flex PCB는 카메라 모듈과 각 부품간의 전기신호를 주고받는 역할을 수행하며, 고해상도 구현을 위한 PCB 평탄도 관리기술이 핵심기술이라고 할 수 있습니다. 대덕전자는 FR-5 Thin core를 삽입한 고평탄도 Rigid Flex기술을 세계 최초로 개발했으며, Tilt 관리기술(Flat PCB, unbalance dual camera, 3D metal cavity) 및 PCB 고집적화기술(Rigid Flex mSAP, Rigid Flex Button via fill) 등을 통해 카메라 모듈용 Rigid Flex PCB 글로벌시장을 선도하고 있습니다.

■ 기업 연혁

1965년	대덕산업 설립
1972년	대덕전자 설립
1979년	석탑산업훈장 수상
1982년	"다층 인쇄회로기판"개발로 국무총리 표창 수상
1985년	성실납세업체 재무부장관 표창수상
1987년	대덕산업 상장
1989년	대덕전자 상장
1990년	제 24회 조세의 날 기념 "동탑산업훈장" 수상
1993년	Silver Through Hole PCB 뉴미디어 상품 대상
1997년	무역의날 1억불 수출의 탑 수상
1999년	"금탑 산업 훈장" 수상
2000년	"2억불 수출의 탑" 수상 대덕산업, 대덕GDS로 상호변경
2002년	납세의날 기념 대통령 산업포장 수상 세계일류상품 선정(Build UP PCB, 산자부)
2007년	상공의날 기념 은탑산업훈장 수상
2011년	대한민국 안전대상 수상
2012년	대덕역사관 개관
2013년	"6억불 수출의 탑" 수상
2015년	대덕전자 창립 50주년 현대/기아자동차 SQ마크 'A등급' 인증 취득
2017년	WISOL 인수
2018년	대덕전자, 대덕GDS 흡수합병
2019년	삼성전자 "Best Contribution Award" 수상
2020년	회사분할 (존속회사 대덕, 분할신설회사 대덕전자)



카메라모듈용 Rigid Flex PCB



고평탄도 Rigid Flex PCB

Flat PCB